

HyperLynx 高速仿真技术及实例培训

时间：8 月 28 日 地点：深圳软件园

随着 AI 及 AR 技术的发展，为了满足各种智能、通信等电子设备小型化和多功能化的要求，现代印制电路板已经在高速、高密度、高集成度发展的道路上。DDR3、DDR4 以及高速 SERDES 串行接口技术也已经广泛应用于产品的研发设计中。PCB 设计复杂度逐步提高，对于信号完整性的分析除了反射，串扰以及 EMI 之外，稳定可靠的电源供应也成为设计者们重点研究的方向之一。尤其当开关器件数目不断增加，核心电压不断减小的时候，电源的波动往往会给系统带来致命的影响。面对激烈的市场竞争，智能硬件在实现产品化的过程中，将面临着研发成本、开发周期、产品可靠性等多方面挑战。

为此奥肯思科技公司及深圳 ICC 将携手共同主办本次培训，旨在分享如何在设计中使用当今最先进的电路仿真技术，使设计有依可循、使一板成功常态化。

在这次课中可以学到：

- 高速高密度 PCB 设计新挑战
- 信号反射理论揭秘
- DDR3 PCB 仿真关键要素
- 高速 SerDes 仿真技术
- 如何摆脱直流压降问题
- 如何通过电源仿真进行 Cost Down

适合的听众：

- 硬件工程师
- PCB 设计工程师
- SI/PI 工程师

讲师简介：



贺营

奥肯思科技公司，SDD 部门资深技术应用工程师

贺营先生于 2014 年加入奥肯思科技公司，负责公司的 SDD 产品技术支持工作。熟悉 PCB 设计、生产等，具有丰富的高速 PCB SI/PI 仿真设计经验。拥有接近十年的通信领域高速 PCB 复杂系统设计与仿真的分析技术。



黄捷

奥肯思科技公司，SDD 部门产品经理

黄捷先生主要负责 Mentor PCB 及系统仿真设计软件的服务和支持工作。2001 年毕业于电子科技大学，曾在华为公司等从事高速 PCB 设计仿真工作。于 2004 年加入奥肯思科技公司，长期为中国各科研院所、高科技电子企业提供电子平台咨询、培训以及实施服务，且设计和管理方面经验丰富。

HyperLynx 高速仿真技术及实例培训

时间：8月28日 地点：深圳软件园

培训时间：8月28日 星期二，9:00-17:00

培训地点：深圳集成电路设计产业化基地管理中心
深圳市南山区科技中二路深圳软件园1期四栋615

乘车路线：乘坐公交683路在深圳软件园下车
或公交682路在深圳软件园西下车，步行50米即是。



免费报名参加：每位来宾都将获得精美礼品一份！，席位有限，请您尽早报名！

1. 将下列回执Email至联系人处； 2. 致电联系人报名

奥肯思科技联系人：

赵代群

电话：18588225028 / 0755-86549109

Email: daiqunzhao@aconsys.com

朱慧

电话：021-54591058

Email: zhuhui@aconsys.com

深圳ICC联系人：

虞纯果

电话：0755-86168846

Email: Tuocg@szicc.net



扫码在线报名



关注微信公众号，
了解更多资讯！

报名截止日期：2018年8月27日

回 执

姓名：	
公司：	
部门：	职位：
手机：	
Email：	